

Buchsenleisten:

Liegende Variante mit max. 20 Polen

Die *Buchsenleisten-Serie* der Fa. Fischer Elektronik ist in niedriger Bauhöhe im Raster 2,54 mm lieferbar und wurde um eine neue *Variante in SMD-Ausführung* erweitert. Neben den bereits bestehenden 1- und 2-reihigen Ausführungen wird hier die liegende einreihige Ausführung dem Produktprogramm hinzugefügt. Die neue Ausführung wird in Polzahlen von 2- bis 20-polig angeboten.

Es stehen zwei Oberflächenvarianten zur Auswahl: verzinkt (komplett) und selektiv vergoldet (Steckbereich vergoldet, Lötbereich verzinkt). Als Grundlage für die Endbeschichtung wird der gesamte Kontakt zuerst mit einer galvanischen Nickel-Sperrschicht überzogen. Die Fertigung des Federkontaktes am Trägerband ermöglicht eine selektive Vergoldung nur im Kontaktbereich. Hierdurch wird ein äußerst sparsamer Goldverbrauch erzielt. Die Lötseite wird verzinkt.



Die Federkontakte sind zum Stecken von 0,635-mm-Vierkantkontakten oder entsprechenden Flachkontakten geeignet. Die Isolierkörper werden aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff gefertigt, geeignet für SMT-Lötverfahren. Die Federkontakte, mit stabil gestaltetem Lötbereich, werden aus Federbronze hergestellt. Der Isolierkörper ist so gestaltet, dass die Kontaktfeder komplett abgedeckt ist und weder eine unzulässige Berührung noch ein sogenanntes „Hinterstecken“ ermöglicht.

Fischer Elektronik
www.fischerelektronik.de

Leistungs-Steckverbinder:

Umwelteinflüsse werden abgeschottet

Die *zweipoligen AMP-MCP-9.5-High-Power-Steckverbinder* von TE Connectivity sind für Draht-zu-Draht- und Draht-auf-Leiterplatten-Verbindungen ausgelegt. Die Verbindungselemente nutzen die bewährten AMP-MCP-9.5-Kontakte von TE, die für einen Nennstrom von 78 A bei einer Drahtstärke von 10 mm² ausgelegt sind.

Die zweipoligen Steckverbinder sind aus extrem belastbarem Thermoplast und halten starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand. Sie sind entsprechend IP 67 und IP 69K klassifiziert und schützen Verbindungen vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Darüber hinaus können sie bei einer langfristigen Betriebstemperatur von -30 bis

+100 °C eingesetzt werden. Die Steckverbinder verfügen über eine integrierte Sekundärverriegelung, welche die Kontaktausrichtung und -haltekraft sicherstellt. Für das einfache Zusammenstecken wird eine Schiebeverriegelung genutzt. Von der fliegenden über die gedichtete und ungedichtete Flansch- bis hin zur Leiterplattenmontage stehen dem Anwender mehrere Montageoptionen offen.

TE Connectivity
www.te.com

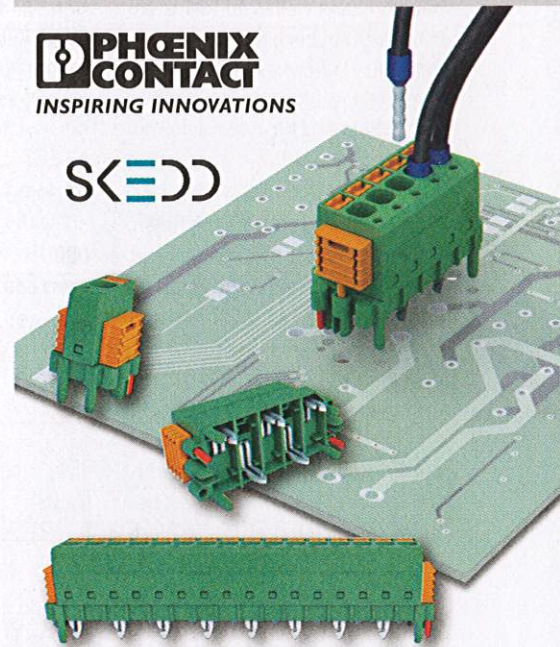


Wir liefern passive und elektro-mechanische Bauelemente von führenden Herstellern

Sofort ab Lager

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

SKEDD



Die neue Art zu kontaktieren

Direktsteckverbinder mit SKEDD-Technologie

PHOENIX CONTACT präsentiert die weltweit ersten Direktsteckverbinder mit Push-in-Federanschluss. Dank SKEDD-Technologie werden Bauteil- und Prozesskosten deutlich reduziert.

Positionieren, einstecken und verrasten: So einfach wird die Serie SDC mit der Leiterplatte verbunden.

Innovationen von PHOENIX CONTACT und Service von GUDECO, eine erfolgreiche Einheit.



WWW.GUDECO.DE

Eine wichtige Komponente Ihres Erfolges

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

Berlin +49 30 29369779 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

✉ info@gudeco.de